



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИПОЙ SN97CU3

Состав сплава в соответствии с требованиями J-STD 006B, IEC 61 190-1-3,  
Сортамент припоя в соответствии с требованиями ГОСТ 21931-76

Припой бессвинцовый, для пайки меди, толщина 2 мм, 250 грамм, Solder Chemi (Россия) используется для пайки медных, латунных и бронзовых фитингов и трубопроводов. Среди бессвинцовых припоев Sn97Cu3 является наиболее эффективным и дешевым для использования в конструкционной пайке.

Паяное соединение обладает достаточно высокой прочностью. Обладает достаточно высокими показателями по растекаемости, в т.ч. по таким поверхностям как сталь. Припой обладает высокими показателями по электропроводности и по теплоемкости.



### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:

- ручная
- выводной монтаж
- конструкционная пайка
- групповая пайка
- прочие случаи пайки

### ФОРМА ВЫПУСКА

- пластина (8.0x20x330) мм
- катушка: 100 г, 250 г, 500 г, 1 кг

### ХРАНЕНИЕ

- хранить в сухом месте

### ПАЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- медь
- медные сплавы
- сталь

### АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

- Припой Sn97Cu3, толщина 2.0, 100 грамм
- Припой Sn97Cu3, толщина 2.0, 250 грамм
- Припой Sn97Cu3, толщина 3.0, 100 грамм
- Припой Sn97Cu3, толщина 3.0, 250 грамм

### ПАРАМЕТРЫ СПЛАВА SN97CU3

Температура солидуса /ликвидуса	227 /310°C
Плотность сплава	7.32 г/см <sup>3</sup> (при темп. 22°C)
Удельное электросопротивление	18 МОм•м (при темп. 22°C)
Теплопроводность	61 Вт/м•°C
Предел прочности на растяжение	57,0 МПа (при темп. 22°C)
Предел прочности на сдвиг	21,0 МПа (при темп. 22°C)
Предел прочности на сдвиг	20.0 % (при темп. 22°C)